



南京峰岳电子科技有限公司

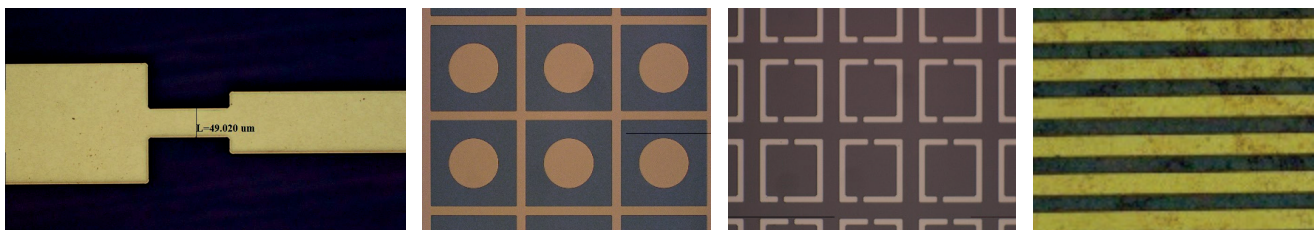
主要产品:

石英薄膜电路: 15 μm 、30 μm 、50 μm 、75 μm 、100 μm 及127 μm 石英电路

氧化铝薄膜电路: 30 μm 、50 μm 、75 μm 、100 μm 、127 μm 及254 μm 氧化铝电路

氮化铝薄膜电路: 30 μm 、50 μm 、75 μm 、100 μm 、127 μm 及254 μm 氮化铝电路

其他定制产品: 芯片电容、人工电磁结构、滤波器、功分器、薄膜电阻、氮化铝热沉等



一、石英 / 氧化铝 / 氮化铝薄膜电路:

本公司拥有薄膜电路完整生产线, 可为客户提供从材料、设计、制造到应用的一站式薄膜混合集成电路解决方案, 广泛应用于微波 / 毫米波电路、光通信、医疗、汽车、LED、光伏、军工等领域。包括厚度为 127 μm 、100 μm 、75 μm 、50 μm 、30 μm 、15 μm 的石英 / 氧化铝 / 氮化铝等基底的薄膜电路, 支持单面和双面金属化图形。

石英基片厚度	单位	误差范围
15	μm	± 3
30	μm	± 5
50	μm	± 5
75	μm	± 5
100	μm	± 5
127	μm	± 6

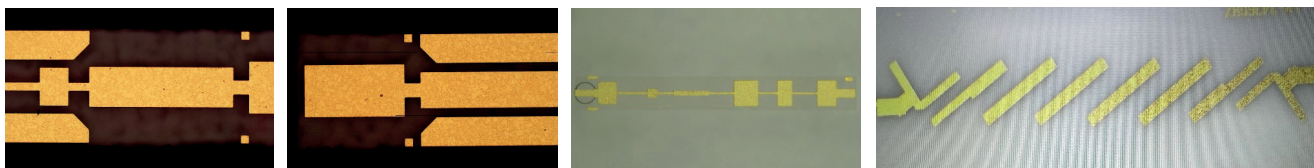
陶瓷基片厚度	单位	误差范围
30	μm	± 5
50	μm	± 5
75	μm	± 5
100	μm	± 5
127	μm	± 5
254	μm	± 5

基片切割误差：±3μm
金属微带长宽误差：±0.5μm
金层厚度误差：±20%

设计规则：

线宽/线距：≥ 5μm 线宽精度：±0.5μm
线距精度：±1μm 金层厚度≤5μm
金锡厚度≤15μm 电路切割最小尺寸：长/宽≥180μm

附图：实际加工的石英样品图



溅射：Ti、TiW、TaN、Au、NiCr、Cu、Ni、Cr和Pt等
电镀：Ni、Cu、Au、AuSn
蒸发：Ti、Pt、Au、Ge等

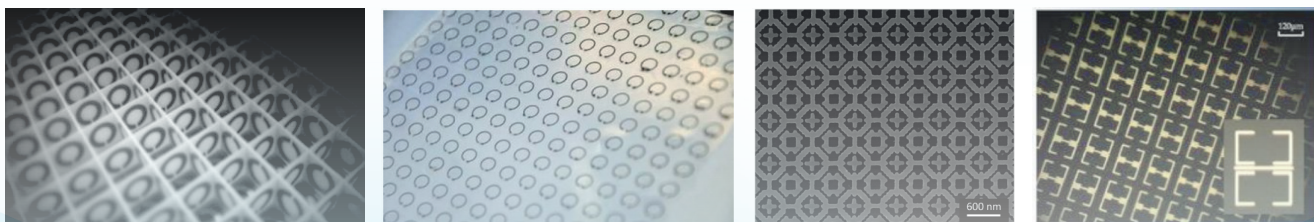
二、超材料结构加工业务：

加工业务范围：加工超材料结构（metamaterial）、亚波长尺度的微纳阵列结构、表面等离子体结构（plasmonics structure）、频率选择表面（Frequency selective surface）结构等。

加工精度：最小特征尺寸 800nm

基底选择：GaN HEMT、高阻硅、蓝宝石、石英、碳化硅、砷化镓等

加工尺寸规格：2 寸片；3 寸片；4 寸片。

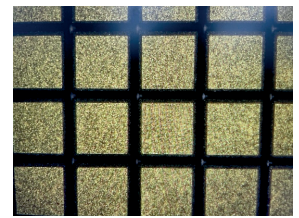
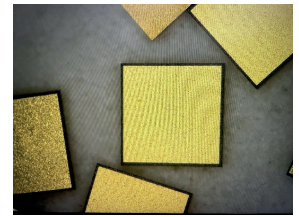


三、芯片电容：

我公司单层芯片电容器系列可插拔替代 DLI 公司 D、E、G、F 系列 ATC 公司 113、116、117、118 系列。薄膜金终端，防静电；结构坚固，表面金层适用于搭线操作；无留边垂直侧面设计便于用户匹配电容宽度与线路板导体线宽，留边设计可减少贴装时短路可能性；适用频率 100MHz~100GHz，产品谐振频率高；适用于射频、微波和毫米波电路中作隔直、旁路、耦合、调谐和滤波等用途。

目前可提供一下芯片电容：

容值	长	宽	厚度	瓷片类型
8.2pF	0.36	0.36	0.152	一类瓷
22pF	0.3	0.3	0.152	二类瓷
22pF	0.38	0.38	0.152	二类瓷
100pF	0.6	0.6	0.152	二类瓷
100pF	0.32	0.32	0.152	三类瓷
100pF	0.3	0.3	0.2	三类瓷
180pF	0.32	0.32	0.152	三类瓷
180pF	0.6	0.6	0.152	二类瓷
1000pF	0.65	0.65	0.152	三类瓷



四、薄膜检验标准：

一般项目

项目	单位	标准能力	试验方法
外形尺寸公差	μm	砂轮切割：±3μm	测量显微镜
线宽 / 线距	μm	±0.6μm	测量显微镜
电阻精度	%	±10	万用表
金属膜厚度	%	±20	台阶仪

检验方法：

外观：20X显微镜下，全数检验，必要时可使用刻度显微镜、三维形貌仪、台阶仪等测试仪器

尺寸：用刻度显微镜测量：按照GB2828.1-2015规定抽检

电阻：用万用表和探针结合测量，按照GB2828.1-2015规定抽检

附着力：3M胶带测试法；按照GB2828.1-2015规定抽检

联系方式：

邮编：210037

地址：中国南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方5幢

电话：+86-25-84812008；传真：+86-25-84812098

电邮：tmtnanjing@163.com；tmtnanjing@gmail.com

网站：www.fyetc.com